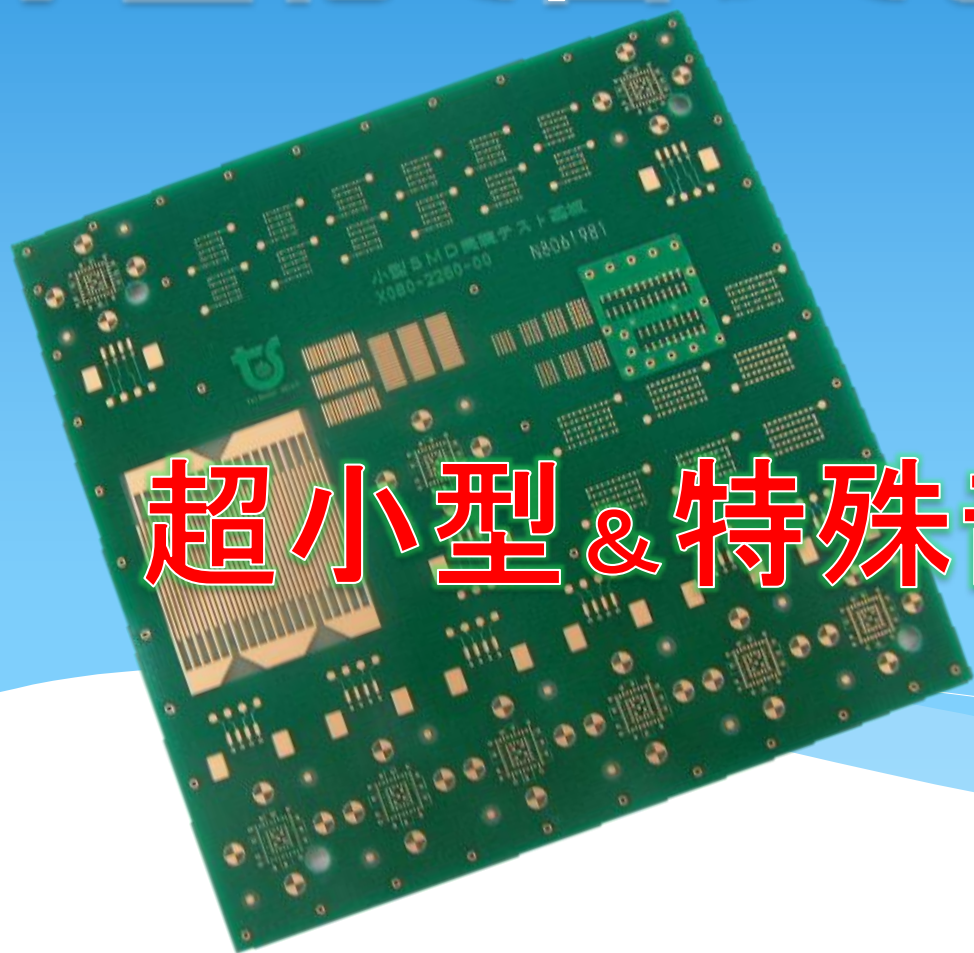


チップ部品サイズの 小型化で困ってませんか？



超小型 & 特殊部品の実装


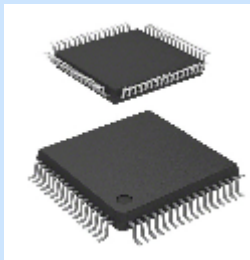
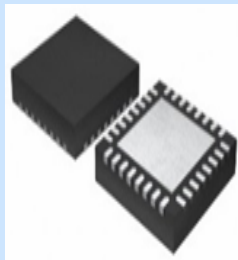
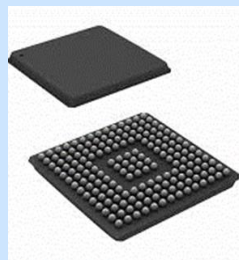
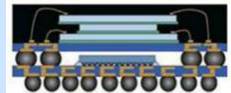


株式会社 对松堂

TAISHODO

弊社で実装可能な部品種類

■ ICパッケージ別実装実績（量産）

名称	SOP	QFP	QFN	BGA	PoP (Package on Package)
外観					
最大 ピン数	86pin	304pin	64pin	1056pin	420pin
最小 ピッチ	0.4mm	0.4mm	0.5mm	0.5mm ※(0.4mm) ベトナム工場	1.0mm ※蘇州工場

弊社で実装可能なチップ部品サイズ

サイズ	1608	1005	0603	0402
対応状況	可能	可能	可能 (2013年～)	試作基板対応済 (日本国内:2015年実施) (海外拠点:2018年実施) 量産未実施(応相談)

日本・中国(シンセン/蘇州)、ベトナムの全工場
0603チップサイズの実装が可能 です。

全工場で0603チップサイズが実装可能な設備を保有

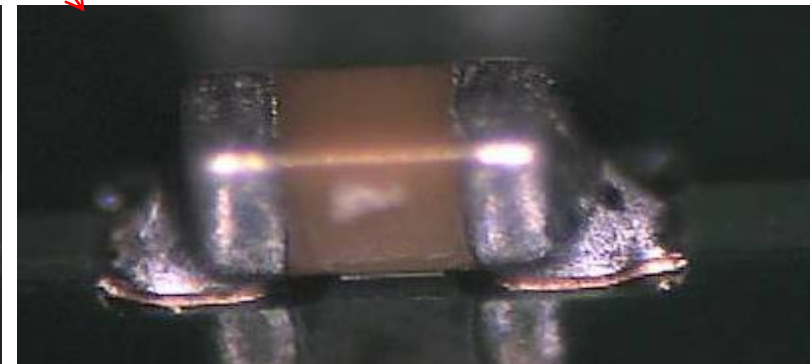
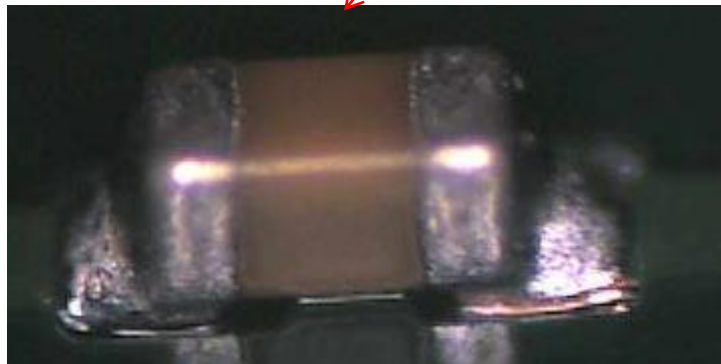
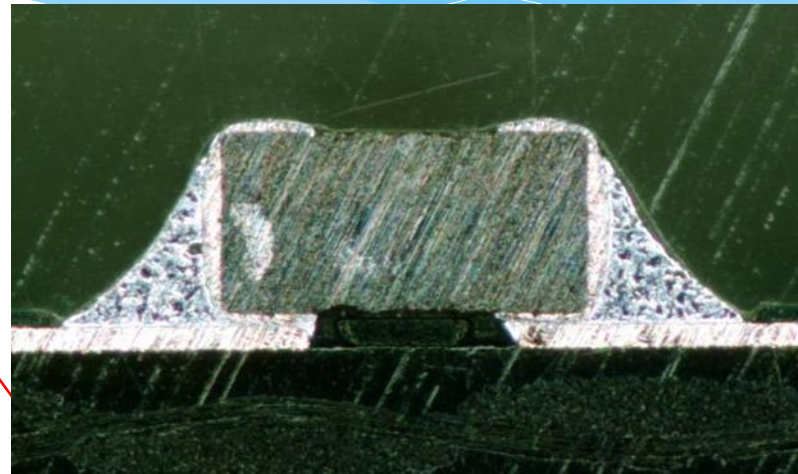
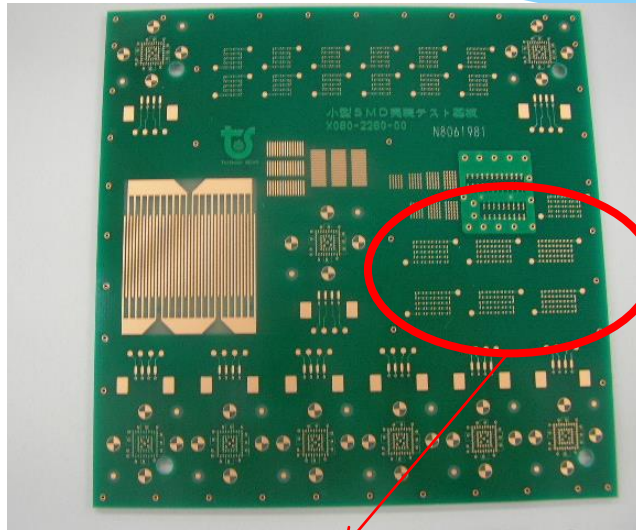
- ① クリームはんだ印刷
- ② クリームはんだ検査機
- ③ チップマウンタ・リフロー炉

全工場で同一設備を使用しているため、日本→海外拠点、海外拠点→日本、
などの生産移管も問題無く対応します。

※但し、フレキシブル基板、表面処理がはんだレベラーの基板には対応して
おりませんのでご了承ください。

評価基板によるはんだ付け状態

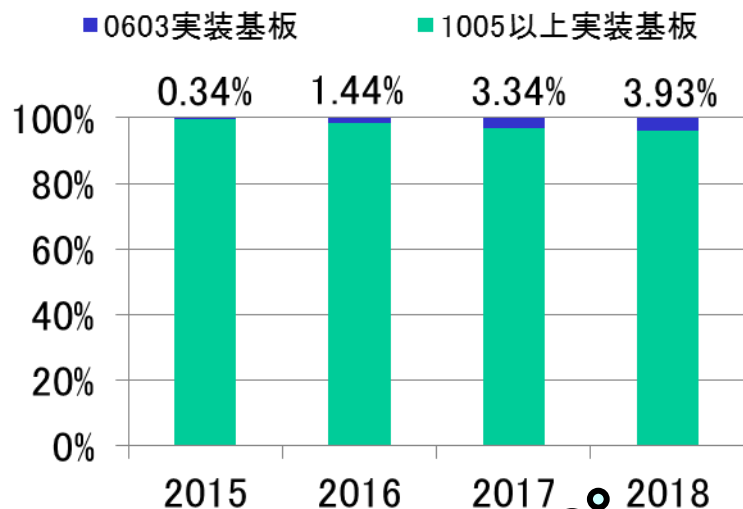
※評価基板は弊社設計
100×100×1.0mm 両面



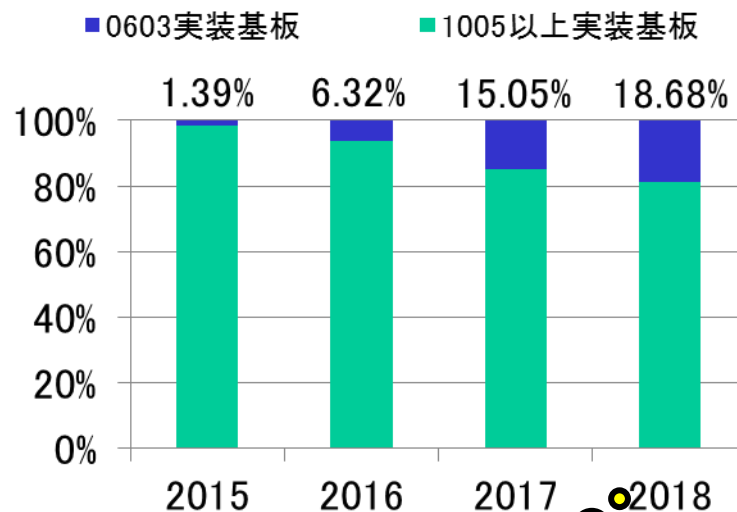
0603部品のはんだ付け写真

対松堂グループ 0603チップサイズ実装比率の推移

出荷台数ベース



出荷金額ベース



新設計品のチップコンデンサは0603採用がほとんど

海外生産で付加価値が高い製品の量産で使われている

0603部品実装は**微少な塵**も品質に**影響**します！

▼弊社では、以下の対策をおこなっております。

- ①低湿度時における加湿（静電気による塵付着の防止）
- ②工場内に段ボール等持ち込みの厳禁
- ③SMTライン投入前プリント板自動清掃
- ④SMTライン内搬送コンベア防塵カバー設置
- ⑤工場出入り口2重扉、空調稼働による防塵

0603チップ部品サイズの 電気検査 について

実装密度が上がり、テストパッドの付与が著しく制限されるため、検査可能範囲も低下してしまいます。

弊社として、可能な限り電気検査方法のご提案をさせていただき、検査不可部品に関しては、外観検査装置もしくは重点目視を実施することで、品質を保証させていただきます。

0603部品 採用・検討にあたって

0603部品の実装品質は実装工程だけでなく、プリント板の設計、あるいは製造品質でも影響されます。

一般的には、シルク印刷の制限、ランド寸法の均一化等、安定実装は種々の制約があります。

採用をご検討される際は、お気軽にお問合せください。

